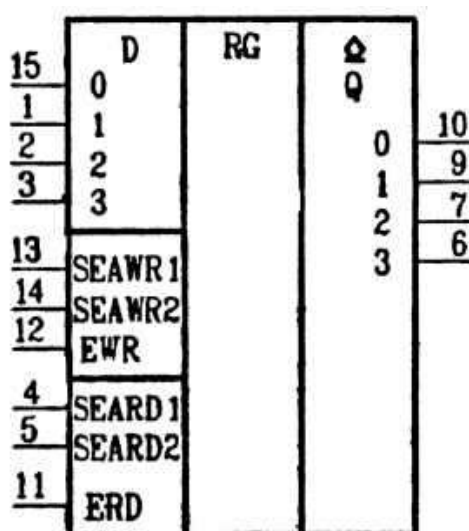


КР1533ИР32, КФ1533ИР32, ЭКФ1533ИР32

Микросхемы представляют собой регистровый файл на четыре четырехразрядных слова (4x4). Обеспечивают раздельное декодирование и адресацию четырех слов как для записи, так и для считывания информации, что позволяет записывать данные по одному адресу и считывать по другому. Пластмассовый корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1...3, 15 - входы информационные D1...D3, D0; 4, 5 - входы выбора адреса считывания SEARD1, SEARD2; 6, 7, 9, 10 - выходы информационные Q3...Q0; 8 - общий; 11 - вход разрешения считывания ERD; 12 - вход разрешения записи EWR; 13, 14 - входы выбора адреса записи SEAWR1, SEAWR2; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР32, КФ1533ИР32, ЭКФ1533ИР32

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В $\pm$ 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$ $\leq 0,4 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$ $\leq 0,5 \text{ В}$

Выходное напряжение высокого уровня при $I_{\text{вых}}^1 = -0,4 \text{ мА}$ $\geq (U_{\text{п}} - 2) \text{ В}$

Ток потребления при $U_{\text{п}} = 5,5 \text{ В}$ $\leq 34 \text{ мА}$

Входной ток низкого уровня:

- по выводам 11, 12 $\leq |-200| \text{ мкА}$
- по остальным выводам $\leq |-100| \text{ мкА}$

Входной ток высокого уровня:

- по выводам 11, 12 $\leq 40 \text{ мкА}$
- по остальным выводам $\leq 20 \text{ мкА}$

Время задержки распространения сигнала при включении:

- от выводов 4, 5, 11 к выводам 6, 7, 9, 10 ≤ 60 нс
- от выводов 12, 1...3, 15 к выводам 6, 7, 9, 10 ≤ 65 нс

Время задержки распространения сигнала при выключении:

- от выводов 4, 5, 11, 12 к выводам 6, 7, 9, 10 ≤ 40 нс
- от выводов 1...3, 15 к выводам 6, 7, 9, 10 ≤ 35 нс

Емкость входа, выхода ≤ 8 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания4,5...5,5 В

Входное напряжение низкого уровня0...0,8 В

Входное напряжение высокого уровня2...5,5 В

Максимальное напряжение, подаваемое на выход5,5 В

Температура окружающей среды-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не

более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.